

# 野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資)

## 運用報告書(全体版)

第14期(決算日2023年6月28日)

作成対象期間(2022年6月29日~2023年6月28日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
なお、当ファンドは、2023年3月23日に信託期間を延長する約款変更を行ない、信託期間終了日は2027年6月28日となりましたので、ご留意下さい。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/株式
信託期間	2009年8月27日から2027年6月28日までです。
運用方針	世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、トップダウン・アプローチによる各国・地域のマクロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行ない、組入銘柄を決定します。また、個別銘柄評価とポートフォリオ全体のリスク特性などを総合的に勘案し、ポートフォリオを構築します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104  
(受付時間) 営業日の午前9時~午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	標準価額			ベンチマーク		株組 入比率	株式 先物比率	純資 産額
		税分	込配	み金	期騰	落中			
	円	円	円	%	%	%	%	百万円	
10期(2019年6月28日)	29,545	1,010		△ 1.6	△ 0.6	97.2	—	9,075	
11期(2020年6月29日)	37,651	1,450		32.3	37.7	99.3	—	18,164	
12期(2021年6月28日)	62,327	2,800		73.0	76.1	97.8	—	28,699	
13期(2022年6月28日)	60,702	2,650		1.6	2.3	97.6	—	33,153	
14期(2023年6月28日)	91,149	4,350		57.3	51.1	98.7	—	73,864	

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\* ベンチマーク（=MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース））は、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。

\* MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・ドルベース）は、MSCIが開発した指数で、同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

（出所）MSCI、ブルームバーグ

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準	標準価額		株組 入比率	株式 先物比率
		騰落率	騰落率		
	円	%	%	%	%
(期首) 2022年6月28日	60,702	—	—	97.6	—
6月末	58,606	△ 3.5	△ 3.5	94.2	—
7月末	64,834	6.8	5.4	98.2	—
8月末	61,711	1.7	△ 0.2	98.4	—
9月末	55,657	△ 8.3	△ 11.1	98.0	—
10月末	58,517	△ 3.6	△ 6.0	98.7	—
11月末	62,768	3.4	0.7	97.6	—
12月末	57,120	△ 5.9	△ 9.0	96.1	—
2023年1月末	65,692	8.2	4.2	96.8	—
2月末	70,169	15.6	11.4	96.7	—
3月末	75,067	23.7	19.6	98.0	—
4月末	70,523	16.2	12.0	97.8	—
5月末	91,150	50.2	43.8	98.0	—
(期末) 2023年6月28日	95,499	57.3	51.1	98.7	—

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年6月28日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2022年6月28日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- (横ばい) 米半導体企業の市場予想を上回る2022年4－6月期の決算を好感した一方、米政府から一部の高性能GPU（画像処理半導体）の中国向けの輸出について政府承認を課す新たな規制や、中国国内のスマートフォン販売の低迷が懸念されたこと
- (横ばい) 米利上げペースの減速期待が高まったこと、対中輸出規制による影響についての過度な懸念が後退したこと、一方で、米利上げ長期化や景気後退と企業収益悪化への警戒感が高まったこと
- (上 昇) 米金融引き締め長期化への警戒感が和らいだこと、米ソフトウェア企業によるAI（人工知能）関連分野への巨額投資計画などを背景として高性能半導体の需要が大きく増加するとの見方が広がったこと
- (上 昇) 米利上げ打ち止め期待が高まったこと、米半導体企業の2023年5－7月期の売上高見通しが市場予想を大きく上回ったこと

## ○投資環境

当期の世界の半導体・半導体製造装置株は、当期初、2022年4－6月期の決算発表において、自動車や産業機器、サーバー向け半導体需要の強さなどから市場予想を上回る好決算が相次いだことや、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締めペースを緩めるとの期待感が高まったことなどから上昇して始まりました。しかし、8月下旬にパウエルFRB議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退し下落しました。その後も、9月下旬のFOMC（米連邦公開市場委員会）で大幅利上げが実施されるとの観測が強まったことや、米政府から一部の高性能GPUの中国向けの輸出について政府承認を課す新たな規制、中国国内のスマートフォン販売の低迷などが懸念され、下落基調となりました。

10月中旬には、米政府が中国に対して半導体製造装置の輸出規制の強化を発表したことを背景に下落しましたが、7－9月期の企業決算が投資家の規制強化に対する過度な懸念をある程度払しょくするような内容となったことや、一部メディアが米金融当局が年内に利上げペースの減速を協議する可能性を報じたことなどが好感され、上昇に転じました。12月中旬には、FOMCで市場予想通りに利上げ幅縮小が実現したものの、継続利上げの必要性を強調するパウエルFRB議長の発言をきっかけに、景気後退と企業収益悪化への警戒感が高まり下落しました。

2023年1月に入ると、FRBの金融引き締め長期化への警戒感が和らいだことや、米ソフトウェア企業によるAI関連分野への巨額投資計画などを背景として大量の情報を素早く処理できる高性能半導体の需要が大きく増加するとの見方が広がり、上昇しました。期末にかけては、米半導体企業が5－7月期の売上高についてデータセンター向け半導体需要の強さなどから市場予想を大幅に上回る見通しを発表したことなどから急上昇し、当期において世界の半導体・半導体製造装置株は大幅な上昇となりました。

一方、為替市場ではFRBが金融引き締め政策を継続するとの見方が広がったことなどから日米の金利差が拡大したことなどを背景に2022年10月下旬にかけて米ドル高・円安が進行しました。その後、FRBの利上げペースの減速に加え、日銀が金融緩和策を見直し実質的な利上げに転換したことから日米金利差の縮小期待が強まり2023年1月にかけて米ドル安・円高が進行しましたが、FRBの利上げ継続長期化観測などを受けて再び日米金利差が拡大したことで期末にかけて米ドル高・円安が進行し、当期において米ドル高・円安となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

期を通じておおむね高位を維持しました。

### ・期中の主な動き

- (1) 地域・国別配分では、米国、オランダ、ドイツなどをオーバーウェイト（ベンチマークに比べ高めの投資比率）としました。一方、台湾、日本などをアンダーウェイト（ベンチマークに比べ低めの投資比率）、中国などを非保有としました。
- (2) 個別銘柄では、エヌビディア（米国）、台湾セミコンダクター（台湾）、ブロードコム（米国）などを上位に組み入れました。
- (3) 為替につきましては、ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

ベンチマーク（MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）が51.1%の上昇となったのに対して、基準価額は57.3%の上昇となりました。

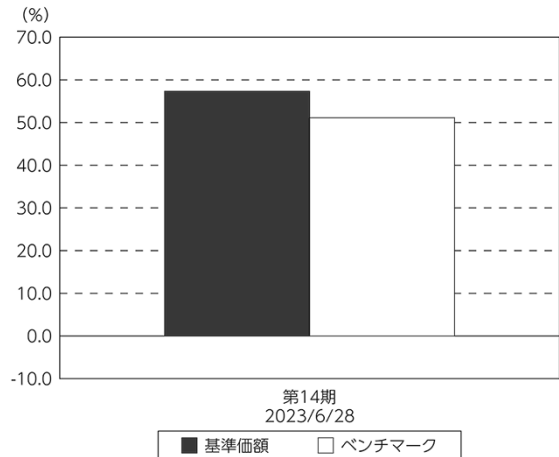
### （主なプラス要因）

- ①地域・国別配分で、株価騰落率がベンチマークを下回った中国を非保有としたこと
- ②個別銘柄において、株価騰落率がベンチマークを上回った、エヌビディア（米国）などをオーバーウェイトとしたこと

### （主なマイナス要因）

- ①地域・国別配分で、株価騰落率がベンチマークを上回った日本をアンダーウェイトとしたこと
- ②個別銘柄において、株価騰落率がベンチマークを下回ったクアルコム（米国）をオーバーウェイトとしたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment（税引後配当込み・円換算ベース）です。

## ◎分配金

今期の収益分配金については、基準価額水準等を勘案し、1万口当たり4,350円とさせていただきます。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第14期
	2022年6月29日～ 2023年6月28日
当期分配金	4,350
（対基準価額比率）	4.555%
当期の収益	4,350
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	81,149

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

### ・投資環境

- (1) 米国経済は、雇用や個人消費などの経済指標は底堅く推移していますが、引き続きインフレ率には注視が必要です。6月のFOMCでは、政策金利は据え置きとなりましたが、追加で複数回の利上げが行なわれる可能性が高いとみています。利上げの影響などを受けて景気減速が進み今後のインフレ率は低下していくと想定されますが、引き続き金融政策や景気、物価に対して警戒が必要です。
- (2) 欧州経済は、6月のユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）がおよそ1年間にわたり景気判断の基準となる50を下回るなど、景気の低迷が続いています。一方で、ECB（欧州中央銀行）が注視する6月のユーロ圏CPI（消費者物価指数）の食品、エネルギーを除いたコアインフレ率は前月と比較して一段と高まっており、物価動向は必ずしも楽観できない状況です。引き続き足元の金融引き締め政策が企業業績や景気に与える影響に注視が必要です。

### ・運用方針

- (1) 当ファンドはボトムアップアプローチを重視し、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点から、グローバルに半導体・半導体製造装置市場をリードしていくことができる企業群に投資します。ファンドのポートフォリオ構築にあたっては、地域・国別配分、業種別配分ともに市場の時価総額構成比を意識した配分を行ない、世界の半導体関連株市場全体の動きを反映したリターンの獲得を目指します。
- (2) 銘柄選択においては、中長期的な成長が見込まれる分野として、AI用途向けの半導体や、通信（インフラ）用半導体、先進運転システム向け半導体などに注目しています。PCやスマートフォン向け半導体などは需要の弱さから積みあがった在庫の調整がいつ頃終了するか投資家の関心が集まる一方、自動車向けなどの半導体については足元の需要は底堅いものの景気の不透明感からその継続性を不安視する投資家も増えています。これらの動向が半導体各社の業績に与える影響を考慮しながら銘柄選択を行ないます。
- (3) 当面の運用方針としては、収益性や競争力の高い銘柄を中心に、今後の成長力とバリュエーション（投資価値評価）のバランスに配慮したポートフォリオ構築を行なう方針です。

今後とも、引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年 6 月29日～2023年 6 月28日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 1,089	% 1.650	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 519)	(0.787)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 519)	(0.786)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 51)	(0.077)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	32	0.049	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 32)	(0.049)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	13	0.019	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 10)	(0.016)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 2)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1,134	1.718	
期中の平均基準価額は、65,984円です。			

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

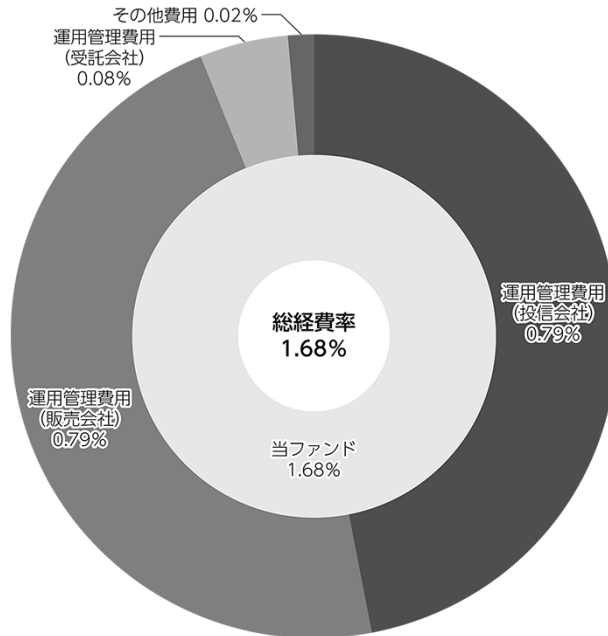
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



**（参考情報）****○総経費率**

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.68%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

(2022年6月29日～2023年6月28日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		( 33)	( —)	—	—
外 国	アメリカ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		19,578	177,408	5,349	62,932
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	—	—	1,317	4,634
	オランダ	121	4,007	—	—
	台湾	6,330	千新台湾ドル	—	千新台湾ドル
		( —)	354,555		—
			(△ 994)		

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\*( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ○株式売買比率

(2022年6月29日～2023年6月28日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	36,166,489千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	38,003,862千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.95

\* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年6月29日～2023年6月28日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ○組入資産の明細

(2023年6月28日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
電気機器 (100.0%)	千株	千株	千株	千円
東京エレクトロン	16.5	49.5	49.5	1,001,880
合 計	株 数 ・ 金 額	16.5	49.5	1,001,880
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	< 1.4% >

\*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

\*銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

\*評価額欄の&lt; &gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADVANCED MICRO DEVICES	809	1,475	16,289	2,343,567	半導体・半導体製造装置
ANALOG DEVICES INC	644	129	2,484	357,374	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS	1,267	1,990	29,174	4,197,369	半導体・半導体製造装置
BROADCOM INC	431	478	40,573	5,837,242	半導体・半導体製造装置
ENPHASE ENERGY INC	407	873	14,057	2,022,512	半導体・半導体製造装置
INTEL CORP	2,266	8,805	30,026	4,319,924	半導体・半導体製造装置
KLA CORP	204	449	21,414	3,080,854	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH	179	378	24,597	3,538,816	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,939	3,171	19,213	2,764,187	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,249	178	1,544	222,233	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	442	3,271	21,852	3,143,869	半導体・半導体製造装置
NVIDIA CORP	1,872	3,160	132,328	19,038,052	半導体・半導体製造装置
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	248	2,278	327,789	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	797	2,455	29,408	4,230,992	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	655	490	8,648	1,244,264	半導体・半導体製造装置

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NXP SEMICONDUCTORS NV		290	130	2,604	374,660	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	13,455	27,684	396,494	57,043,712	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	16	—	< 7.2% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,947	629	2,234	351,922	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,947	629	2,234	351,922	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.5% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		232	353	13,220	2,082,490	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV		370	370	24,078	3,792,778	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	602	723	37,298	5,875,269	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 8.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,549	1,353	39,532	6,227,191	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 8.4% >	
(韓国)				千ウォン		
SK HYNIX INC		427	427	4,836,287	534,893	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	427	427	4,836,287	534,893	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.7% >	
(台湾)				千新台幣ドル		
MEDIATEK INC		710	710	48,351	224,160	半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR		23,260	29,590	1,692,548	7,846,821	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	23,970	30,300	1,740,899	8,070,981	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 10.9% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	40,403	59,766	—	71,876,779	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 97.3% >	

\* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## ○投資信託財産の構成

(2023年6月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	72,878,659	93.2
コール・ローン等、その他	5,336,555	6.8
投資信託財産総額	78,215,214	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産（72,234,876千円）の投資信託財産総額（78,215,214千円）に対する比率は92.4%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=143.87円、1スイスフラン=160.96円、1ユーロ=157.52円、1ウォン=0.1106円、1新台幣ドル=4.6361円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年6月28日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	78,215,214,165
コール・ローン等	5,247,930,645
株式(評価額)	72,878,659,382
未収入金	4,608,684
未収配当金	84,015,454
(B) 負債	4,350,235,341
未払収益分配金	3,525,123,051
未払解約金	436,870,686
未払信託報酬	387,456,484
未払利息	10,267
その他未払費用	774,853
(C) 純資産総額(A-B)	73,864,978,824
元本	8,103,731,154
次期繰越損益金	65,761,247,670
(D) 受益権総口数	8,103,731,154口
1万口当たり基準価額(C/D)	91,149円

(注) 期首元本額は5,461,611,655円、期中追加設定元本額は5,281,762,905円、期中一部解約元本額は2,639,643,406円、1口当たり純資産額は9,1149円です。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額158,728,105円。

## ○損益の状況（2022年6月29日～2023年6月28日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	492,406,395
受取配当金	489,452,341
受取利息	3,167,453
その他収益金	98
支払利息	△ 213,497
(B) 有価証券売買損益	20,616,151,904
売買益	23,712,660,591
売買損	△ 3,096,508,687
(C) 信託報酬等	△ 668,547,808
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,440,010,491
(E) 前期繰越損益金	1,478,597,942
(F) 追加信託差損益金	47,367,762,288
(配当等相当額)	( 13,446,849,298)
(売買損益相当額)	( 33,920,912,990)
(G) 計(D+E+F)	69,286,370,721
(H) 収益分配金	△ 3,525,123,051
次期繰越損益金(G+H)	65,761,247,670
追加信託差損益金	47,367,762,288
(配当等相当額)	( 13,446,849,298)
(売買損益相当額)	( 33,920,912,990)
分配準備積立金	18,393,485,382

\*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

\*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

\*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2022年6月29日～2023年6月28日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年6月29日～ 2023年6月28日
a. 配当等収益(経費控除後)	476,829,231円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	19,217,669,091円
c. 信託約款に定める収益調整金	47,367,762,288円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,224,110,111円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	69,286,370,721円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	85,499円
g. 分配金	3,525,123,051円
h. 分配金(1万口当たり)	4,350円

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（税込み）	4,350円
-----------------	--------

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

信託期間を3年更新し、信託期間終了日を2027年6月28日とする所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2023年3月23日＞